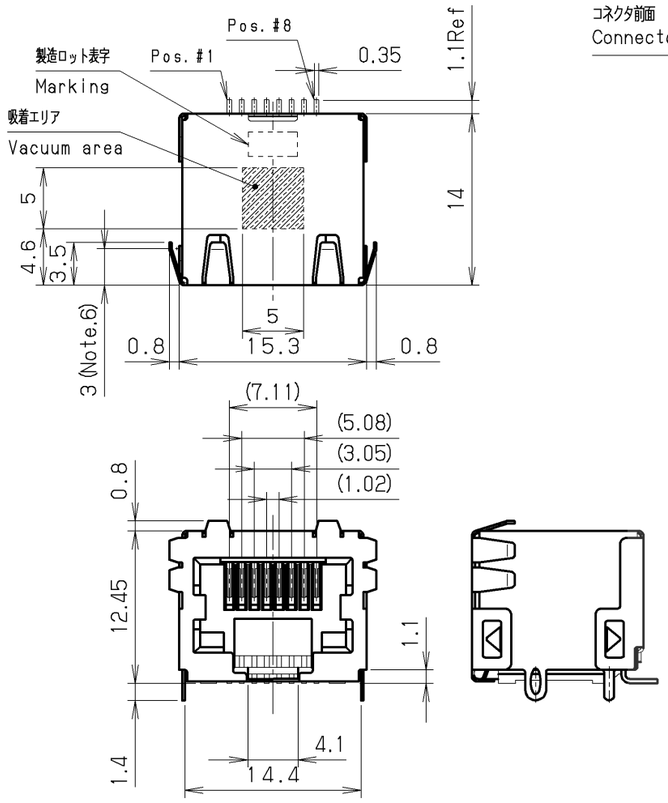
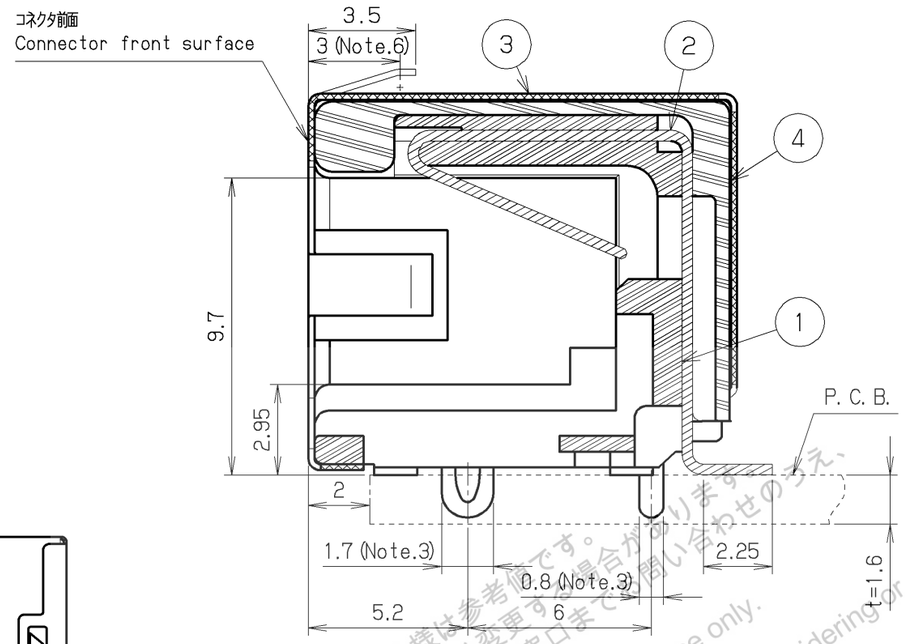
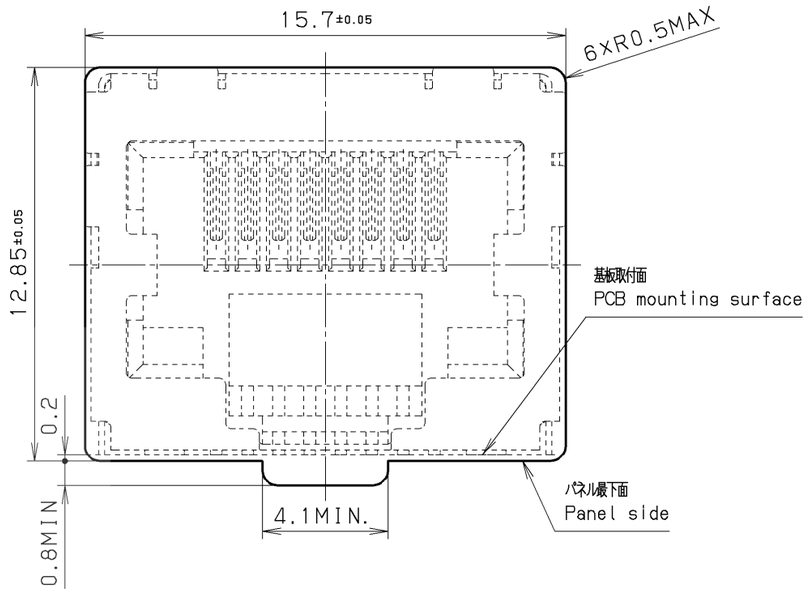




嵌合部詳細（S=5/1）
Contact detail (S=5/1)



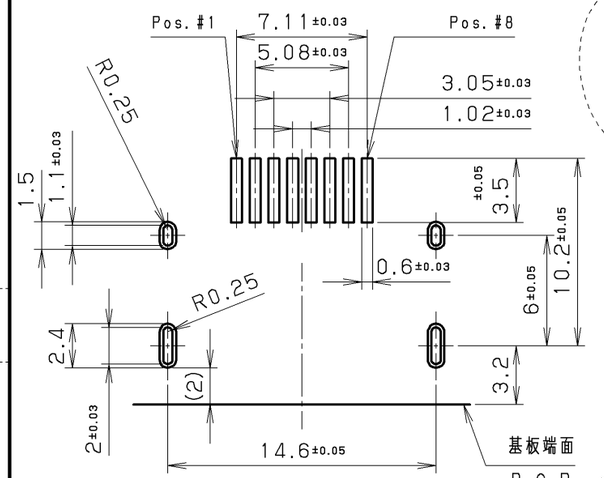
推奨パネル取付寸法（S=5/1）
Recommended Panel Design (S=5/1)

外観
Appearance

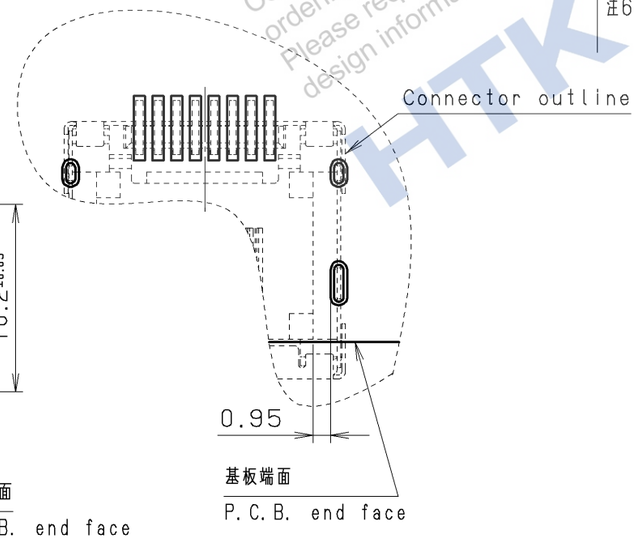
注1．コンタクト処理
接触部　：パラジウムニッケルめっき0.1μm以上
　　＋ 金めっき0.03μm以上
SMT部：金めっき0.03μm上
下地　：ニッケルめっき
注2．コプラナリティ：0.1mm以下
注3．シェル板厚　t=0.2mm
注4．コンタクト処理は、RJ-45の規格ではありません。
注5．リフローDIP対応品（1リフロー実装を想定）

注6．パネル接触ばねの接点位置は、
コネクタ前面より3±0.3mmにて設計しています。

Note
1.Contact plating
Contact area　:Palladium-Nickel 0.1μm min.
　　+ Gold 0.03μm min.
Termination area:Gold 0.03μm min.
Underplating　:Nickel
2.Coplanarity　:0.1mm max.
3.Shell thickness :t=0.2mm
4.Contact plating is not the standard of the RJ-45.
5.This Connector is met by reflow DIP.
(It is possible by once.)
6.The shield contacts are designed in 3±0.3mm
out of connector front surface.



推奨基板レイアウト（S=3/1）
Recommended P. C. B. layout



RoHS compliant

4	絶縁体B Insulator B	PA9T(GF)	1	――	UL94V-0 BLACK
3	シェル Shell	りん青銅 Phosphor bronze	1	ニッケルめっき Nickel	――
2	コンタクト Contact	りん青銅 Phosphor bronze	8	注1 See Note 1	――
1	絶縁体A Insulator A	PA9T(GF)	1	――	UL94V-0 BLACK

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
3									
2									
1									

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法
Feb.17 (2017)	2/1	mm (INCH)	3RD. A. P

製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.
S. WATANABE	S. WATANABE	K. OOAKU	――	K. HOMMA

HTK 本多通信工業株式会社
HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.

名称 NAME: RJ-45形モジュラージャック リバースSMT・パネル接地タイプ(RoHS)
RJ-45 modular jack reverse SMT and panel earth type(RoHS)

製番 PART NO.: MOD-RJ88LY1GA+　REV.

ID= MOD-RJ88LY1GA+ B0

掲載している商品の特性、仕様は参考値です。
採用に当たっては、ご検討願います。
納入仕様書の取交しや注文の際は弊社営業所までご問い合わせのうえ、
ご検討やご注文の際は弊社営業所までご問い合わせのうえ、
ご確認をお願いします。
The product in this data is for reference only.
This subject to change without notice.
Contact our sales staff for further information before considering or ordering any of our products.
Please request Engineering Drawing for the most current and accurate design information.
HTK